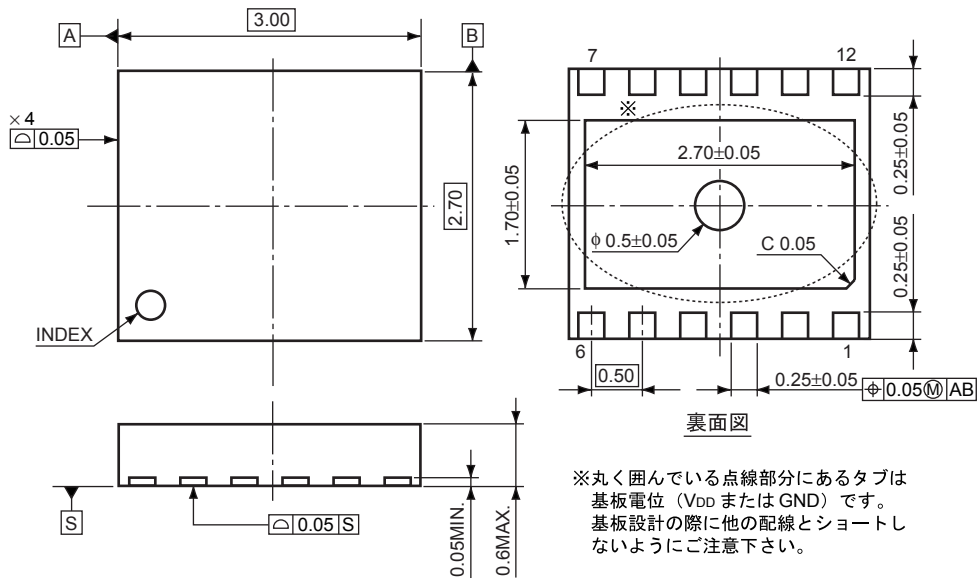


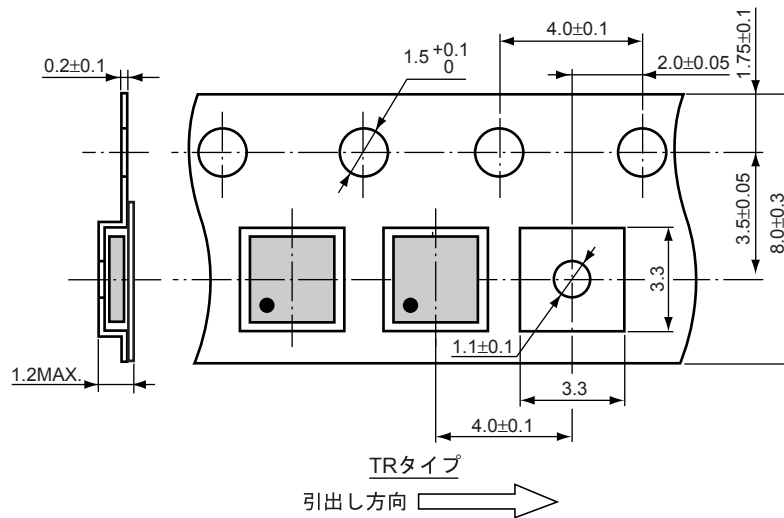
DFN(PLP)2730-12

(単位 : mm)

■ パッケージ外形図

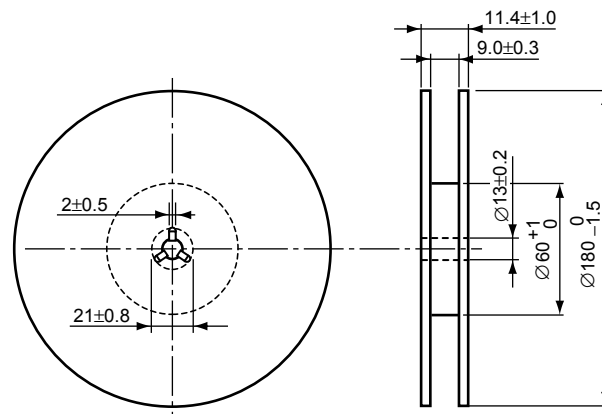


■ テーピング仕様



■ テーピングリール外形図 リュースリール (EIAJ-RRM-08Bc)

(1 リール=5000 個)



## ■ 許容損失について (DFN(PLP)2730-12)

DFN(PLP)2730-12パッケージの許容損失について特性例を示します。

なお、許容損失は実装条件に左右されますので、本特性例は下記測定条件での参考データとなります。

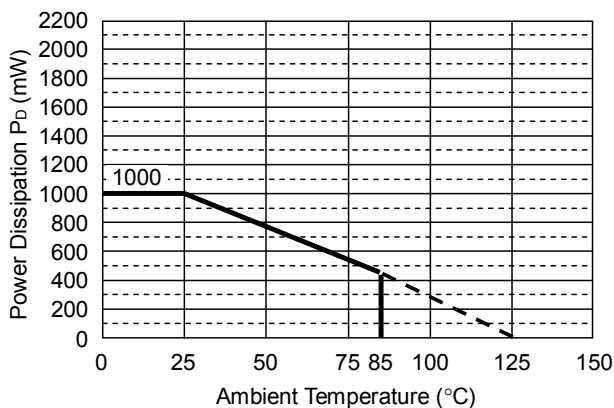
### 測定条件

	標準実装条件	ハイワットテージ実装条件
測定状態	基板実装状態 (風速 0m/s)	基板実装状態 (風速 0m/s)
基板材質	ガラスエポキシ樹脂 (両面基板)	ガラスエポキシ樹脂 (4層基板)
基板サイズ	40mm × 40mm × 1.6mm	76.2mm × 114.3mm × 1.6mm
配線率	表面 約 50%、裏面 約 50%	表裏層 : 50.0mm 角 配線率 10%以下 内層 : 74.2mm 角 配線率 100%
スルーホール	直径 0.54mm × 32 個	直径 0.85mm × 64個 ※タブと内層、および、裏面とを 0.3mm のスルーホールで接続

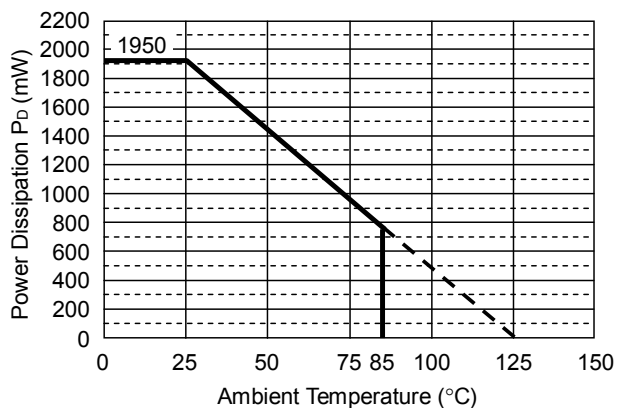
### 測定結果

(Topt=25°C, Tjmax=125°C)

	標準実装条件	ハイワットテージ実装条件
許容損失	1000mW	1950mW
熱抵抗値	$\theta_{ja} = (125-25^\circ\text{C})/1.0\text{W} = 100^\circ\text{C/W}$	$\theta_{ja} = (125-25^\circ\text{C})/1.95\text{W} = 51.2^\circ\text{C/W}$
熱抵抗値	$\theta_{jc} = 18^\circ\text{C/W}$	$\theta_{jc} = 5.9^\circ\text{C/W}$

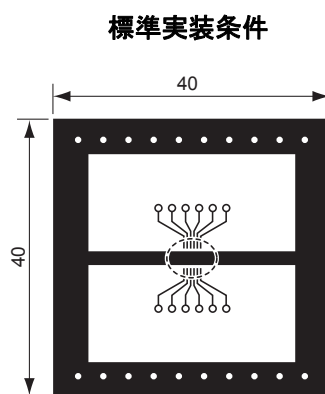
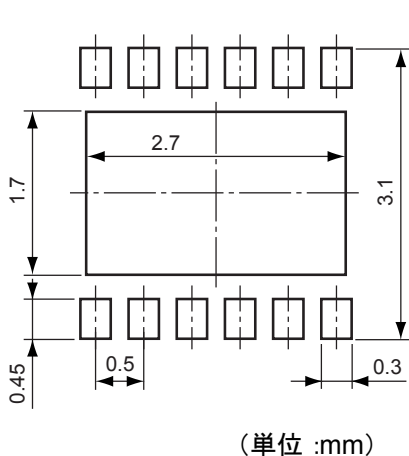


許容損失特性 (標準実装条件)

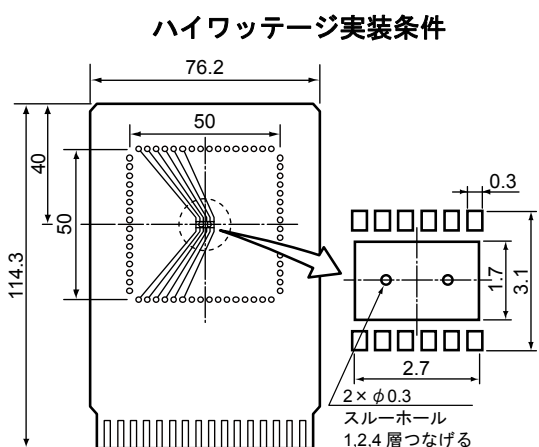


許容損失特性 (ハイワットテージ実装条件)

## ■ 基板パッド推奨寸法 ■ 測定基板レイアウト



標準実装条件



ハイワットテージ実装条件

○ IC 実装位置 (単位 : mm)